

# はんだ接合を支えるフラックス製品!

Flux products to support solder joint

## 残渣レスフラックス Ultra-low residue Flux

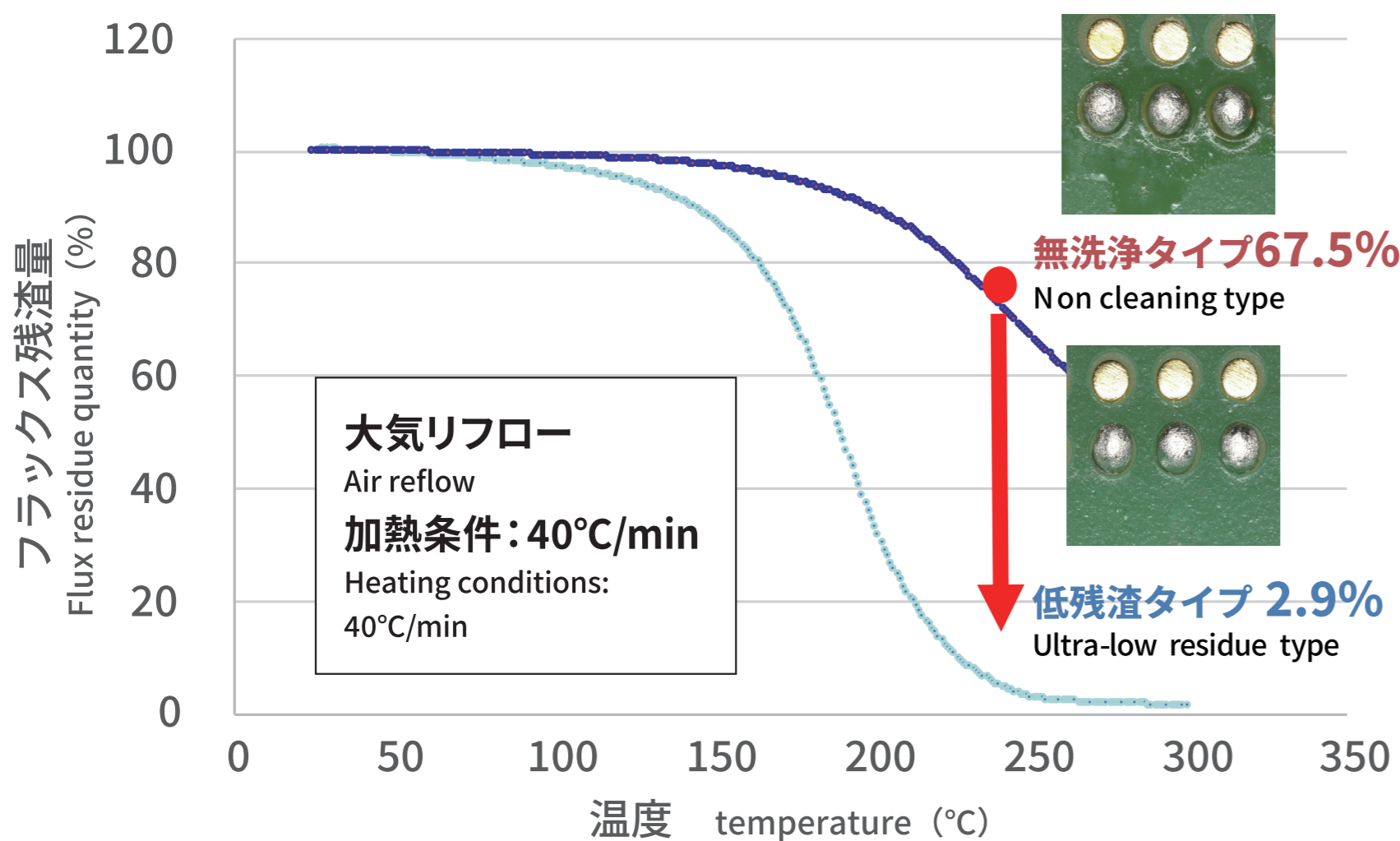
## RLF001

**洗浄工程を削減可能!**  
Cleaning process can be eliminated

**大気リフロー対応可能!**  
Applicable to Air reflow

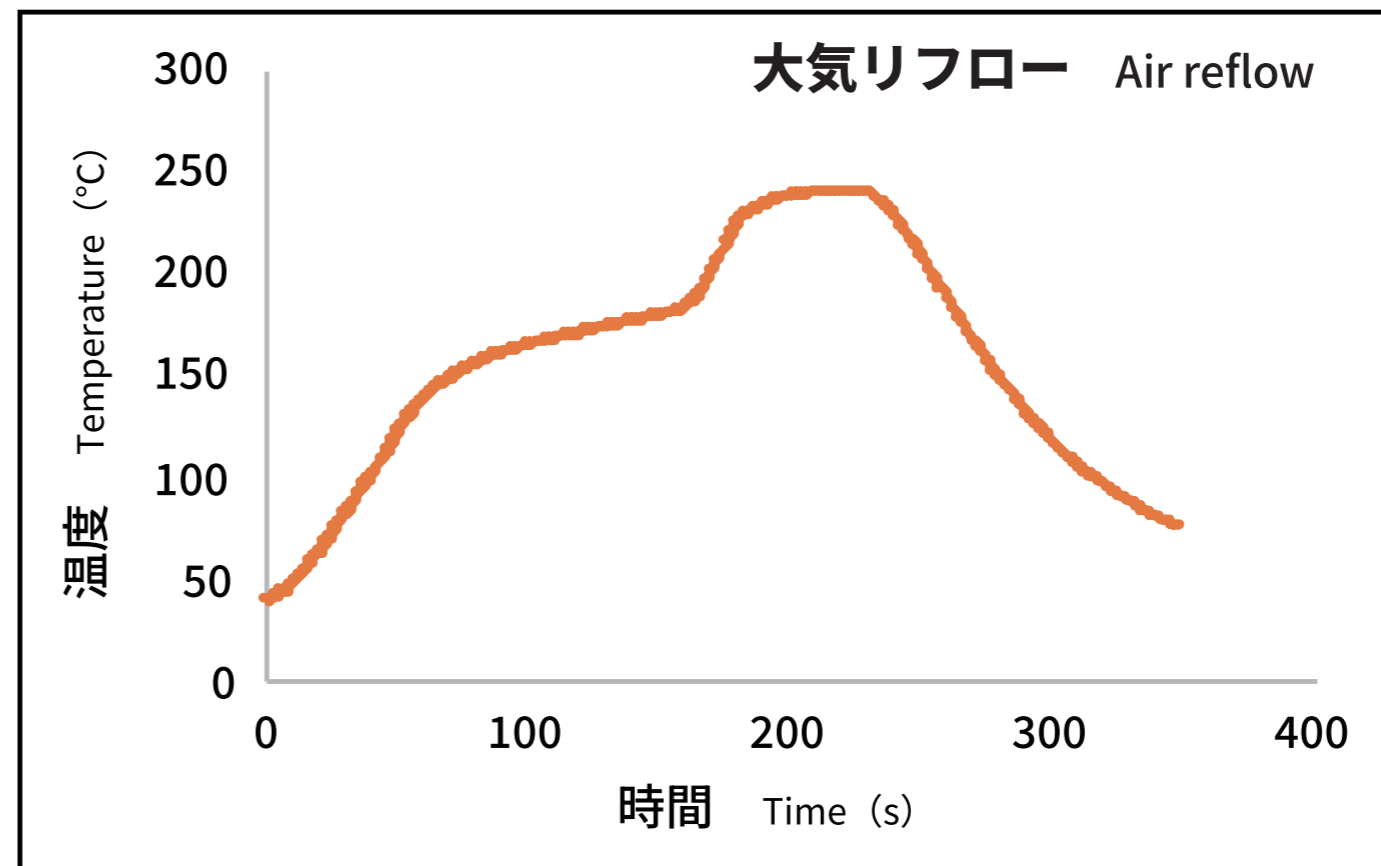
**はんだバンプに対応!**  
Applicable to solder bumps

### 洗浄工程を削減 Eliminate cleaning process



**フラックス残渣量を大幅に低減!**  
Significantly reduced flux residue

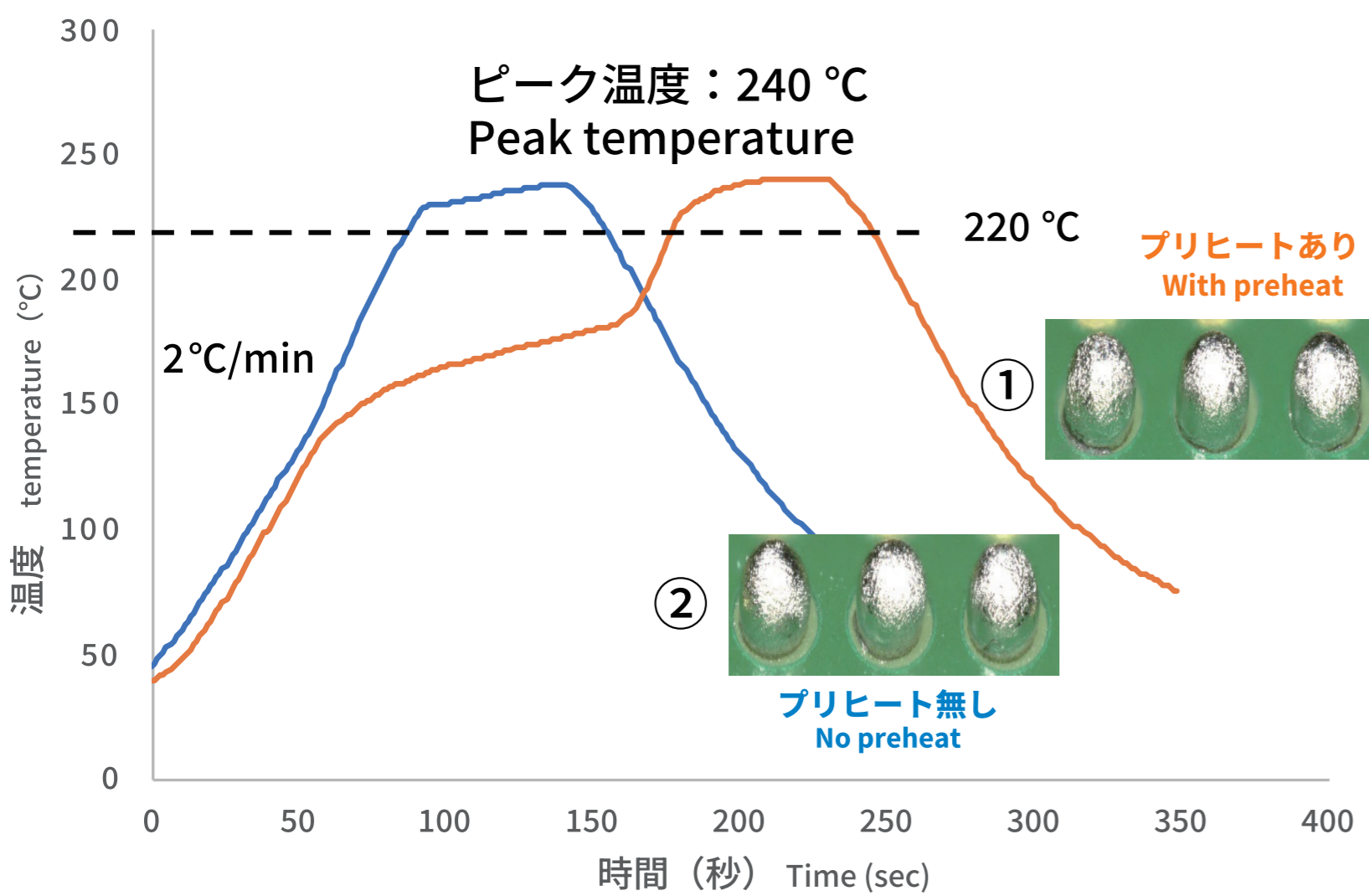
### リフロープロファイル Reflow Profile



### SEM-EDSマッピング SEM-EDS mapping

元素マッピング:C Characteristic X-rays	RLF001		一般的なフラックス Normal flux	
	加熱前 Before heating	加熱後 After Heating	加熱前 Before heating	加熱後 After Heating

### 大気リフロー対応可能 Applicable to Air reflow



**急加熱しても超低残渣でぬれ性も良好!**  
Ultra low residue and good wettability even rapid heating!

### はんだバンプ対応 Applicable to solder bump

特徴 Features	隣接ボールと接合せず、ボールが保持 Balls are not joined with adjacent balls and are retained	ボール表面に窪みが無く、均一で滑らか Uniform and smooth with no depressions on the ball surface	安定した溶融で、溶融後のボール高さが均一 Stable melting, uniform ball height after melting
一般フラックス Normal flux			
残渣レスフラックス Ultra-low Residue Flux			

## フラックス塗布確認用着色剤 含有フラックス

Colorant containing flux to check flux application

## NCBF001

**フラックスを着色する事で検査時に検出可能!**  
Detectable by colored flux

	写真 Photo	フラックス検査(二値化) Flux inspection (binarization)
NCBF001 着色剤含有フラックス Colorant-containing flux		
一般フラックス Normal flux		

